

〈ニュースリリース〉

2006年10月12日

米国デュポン社、太陽インキ製造株式会社と 新半導体パッケージ材料の共同開発契約に合意

米国デュポン社(本社:デラウェア州ウィルミントン、会長兼最高経営責任者:チャールズ・O・ホリデー・ジュニア)のデュポン エレクトロニクステクノロジー事業部は、10月11日(米国時間)、太陽インキ製造株式会社(以下、太陽インキ社)と、フリップチップボールグリッドアレイパッケージに用いるビルドアップタイプの層間絶縁フィルム材料の共同開発契約を締結したと発表しました。

これにより、両社は、この分野での各々の高度な技術、経験、市場への影響力を組み合わせることで、ますます高まりつつある高密度回路と接続信頼性に対する要求を達成する新しい手段を提供できると期待しています。

当面は、低い線膨張係数(CTE)、高い密着強度、信号特性と高速特性に優れた材料を上市することを目標とします。

「半導体業界では、緊密な協力関係と、材料間の調和とが顧客のニーズにとって極めて重要であり、またそれは我々がこの急速に成長する市場で製品を広げるための重要な戦術要素でもある」と、副社長兼デュポンエレクトロニクステクノロジーゼネラルマネージャーであるデービッド・B・ミラーは語っています。「太陽インキ社の独自の樹脂技術と知見に、デュポンのフィラーとその表面改質及び分散技術を組み合わせることで、興味深い特性の材料が、来年初め頃にはOEMの認定作業への供給が可能となる。太陽インキ社との共同開発は、われわれが半導体パッケージ分野に向けた工業材料の開発を推し進めることを示す非常によい例だ。またこの分野は、デュポンの埋込受動部品材料にとっても最も重要なターゲットであり、ここでも材料間の調和が大切となるだろう。」

「太陽インキは、独自のビルドアップ用樹脂材料と、その樹脂とデュポンのフィラー及びその拡散技術との親和性を最大限に高める方法を確認した。我々は、この強力な提携が、顧客と業界にメリットをもたらすものであると考えている」と、太陽インキ社の釜菴(かまやち)裕一代表取締役社長は語っています。

デュポンエレクトロニクステクノロジー事業部は、半導体製造材料、半導体パッケージ材料、硬質及びフレキシブル板基材、高品位ディスプレイ材料をはじめとする電子材料のトップメーカーです。

1802年に創立されたデュポン社は、米国デラウェア州ウィルミントンに本社を置くサイエンス・カンパニーです。世界70カ国余りに拠点があり、エレクトロニクス、輸送、住宅・建築、通信、農業、栄養食品、安全・保護、アパレル分野で、科学の力を生かした持続可能なソリューションを創出し、世界中の人々の生活をより安全で豊かにする製品やサービスを提供しています。

#

以上

この件に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

デュポン株式会社 広報部:岩松

電話(03)5521-8484